

Kappa™ 438层压板材加工指南快速参照表

板材描述：	玻璃布增强的填充陶瓷填料的碳氢树脂体系的复合型覆铜板
存储条件：	室温环境
内层加工处理	
定位孔：	兼容大多数圆形孔和方形孔定位系统
图形转移的前处理：	根据板材的厚度来选择化学清洗或是机械磨刷处理方式
图形转印：	标准的干膜或者湿膜流程
DES 蚀刻：	标准流程，薄板可能需要引导板
氧化处理：	采用氧化处理或者氧化替代法的加工流程
压合	
预处理：	推荐的预烘烤温度125°C - 150°C
多层板的粘结点：	兼容RO4400™粘结点 and 大多数热固型半固化片
多层板压合条件：	采用与粘结点所需要的压合参数
镀通孔和外层/双面线路板加工流程	
钻孔：	标准的盖板/垫板材料，如；铝片和酚醛板，采用新钻头，控制落速、钻速和退刀速。通过检查孔壁质量确定钻头寿命。
去毛刺：	机械方式做磨刷去毛刺可以用于厚的芯板/多层板。
孔的预处理：	化学除胶或是等离子除胶都可以。不推荐使用回蚀工艺；对于加工有CAF要求的产品时，不建议使用化学除胶，要使用等离子除胶。
金属化孔：	无电化学沉铜或是直接金属沉积工艺。
通孔电镀 和外层图形	
最终表面处理：	兼容于大多数金属表面处理和有机阻焊膜表面处理（OSP）。蚀刻之后保护好介质表面的形貌，在印防旱油墨之前对板材做额外的烘烤。
外形加工：	Kappa™ 438 板材可以用铣、冲，或V型槽的工艺，推荐使用钻石割刀或是硬质合金的多刃螺旋铣刀。V型槽的深度控制小于1/2 板材的厚度或是更少。越深的V型槽可能会导致折断边提前断裂。

长时间暴露在氧化环境中，可能造成碳氢材料介电性能的变化。变化的速度会在更高温度是有所增加，并且高度依赖于电路设计。尽管罗杰斯的高频材料已经广泛的应用，并且氧化导致性能问题的报告及其罕见，但是罗杰斯还是建议客户评估每种材料和设计方案，以判断在最终产品的整个生命周期内使用该材料的适宜性。

本加工指南快速参照表中所包含的信息旨在帮助您采用罗杰斯的线路板材料进行设计，无意且不构成任何明示的或隐含的担保，包括对商品适用性、适用与特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途达到本数据表及加工说明中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯线路板材料在每种应用中的适用性。

相关产品、技术和软件根据出口规定出口自美国，禁止违反美国法律。

RO4400, Kappa和罗杰斯标识均为罗杰斯公司（Rogers Corporation）或其子公司的注册商标。
© 2017年罗杰斯公司版权所有, 保留所有权利。中国印刷。
发布于 1268 032917 出版号 #92-540CS